

聚辰半导体股份有限公司

关于申请 2021 年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议决议，公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。

一、本次申请年度综合授信额度的基本情况

为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排，董事会批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件，该项授权自董事会批准之日起一年内有效。本次公司及全资子公司申请年度综合授信额度事项不涉及对外提供担保或相互提供担保的情况。

二、董事会审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》，批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日